

CWS/12/26

ORIGINAL: INGLÉS

FECHA: 5 DE AGOSTO DE 2024

**Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)**

**Duodécima sesión**

**Ginebra, 16 a 20 de septiembre de 2024**

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NORMA ST.91 DE LA OMPI

*Documento preparado por el responsable del Equipo Técnico 3D*

## RESUMEN

El Equipo Técnico 3D analizó las respuestas a la encuesta sobre la aplicación de la Norma ST.91 de la OMPI por parte de las Oficinas de PI y ofrece su análisis de los resultados de la encuesta.

## ANTECEDENTES

En su undécima sesión, celebrada en diciembre de 2023, el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) aprobó el cuestionario sobre la aplicación de la Norma ST.91 de la OMPI por las Oficinas de PI. El CWS pidió a la Secretaría que emitiera una circular en la que invitara a las Oficinas de PI a responder a esta encuesta (párrafo 87 del documento CWS/11/27).

## RESULTADOS DE LA ENCUESTA

En marzo de 2024, la Secretaría emitió la circular C.CWS.179 en la que invitaba a las Oficinas de PI a participar en la encuesta sobre la aplicación de la Norma ST.91 de la OMPI. La encuesta se realizó entre marzo y abril de 2024.

Los 22 miembros del CWS participaron en la encuesta: Oficinas de los siguientes Estados miembros: Alemania (DE), Australia (AU), Bhután (BT), Bulgaria (BG), Canadá (CA), Croacia (HR), Eslovaquia (SK), Estonia (EE), Gambia (GM), Federación de Rusia (RU), Hungría (HU), Italia (IT), Japón (JP), Lituania (LT), Namibia (NA), Reino Unido (GB), República Árabe Siria (SY), República Checa (CZ) y República de Corea (KR); y las siguientes Oficinas regionales: Oficina Eurasiática de Patentes (EA), Oficina Europea de Patentes (EP) y Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EM). La Secretaría publicará las respuestas individuales de las Oficinas de PI y las respuestas agrupadas en la [Parte 7 del Manual de la OMPI](https://www.wipo.int/standards/es/part_07.html) tan pronto como todas las respuestas hayan sido traducidas y formateadas.

## ANÁLISIS DE LA ENCUESTA

La Secretaría proporcionó al responsable del Equipo Técnico 3D las respuestas de la encuesta para que las analizara. El responsable del Equipo Técnico presenta a continuación el análisis para que sea examinado por el CWS.

Entre las respuestas, 12 participantes (55 %) indicaron que aún no utilizan modelos, imágenes o estructuras químicas tridimensionales; nueve (41 %) indicaron que sí los utilizan; y uno (5 %) indicó un uso especial en su respuesta.

Entre quienes respondieron que utilizan modelos, imágenes o estructuras químicas en 3D: el 67 % utiliza el 3D para diseños industriales, el 56 % para marcas, el 44 % para patentes, el 22 % para modelos de utilidad y el 22 % para otros derechos de PI.

Cabe señalar también que, entre las Oficinas que respondieron, la mayoría (64 %) no aplica la Norma ST.91 de la OMPI, mientras que el 27 % la aplica parcialmente y el 9 % la aplica en su totalidad.

En cuanto al uso de los formatos de archivo recomendados por la Norma ST.91 que reciben actualmente las Oficinas de PI:

|  |  |
| --- | --- |
| Derecho de PI | Formato de archivo más utilizado (por orden) |
| Marcas | OBJ, STL, 3D PDF |
| Diseños industriales | 3D PDF, OBJ, STL, STEP |
| Patentes (incluidas las estructuras químicas) | 3D PDF, STEP |
| Modelos de utilidad | 3D PDF |

En cuanto a la publicación de modelos, imágenes o estructuras químicas 3D, recomendada por la Norma ST.91, las Oficinas indicaron que la mayoría no publican la información en 3D recibida aunque haya sido aceptada. Los formatos más utilizados para las marcas son OBJ y STL, mientras que los formatos más utilizados para la publicación de diseños industriales, patentes y modelos de utilidad es 3D PDF. Del mismo modo, en la pregunta relativa a la publicación en papel de objetos 3D, la mayoría de las Oficinas que respondieron no publican información de modelos, imágenes o estructuras químicas 3D en papel aunque hayan sido aceptados por la Oficina. Las Oficinas que sí publican objetos 3D en papel publican los objetos 3D utilizando representaciones 2D generadas a partir de los modelos o imágenes 3D de origen para todos los derechos de PI indicados en la encuesta.

Cabe señalar que ninguna Oficina de PI utiliza los formatos 3D recomendados para la topología de circuitos integrados, sea para su presentación o su publicación.

Durante el examen, la mayoría de las Oficinas utiliza representaciones en 2D para la comparación de los modelos y las imágenes en 3D en lugar de los propios modelos o imágenes en 3D.

## Próximos pasos

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta anterior, que ponen de manifiesto que el número de Oficinas que admiten la presentación, el examen y la publicación de modelos 3D en formatos 3D es bastante bajo, y que las que admiten el uso de formatos 3D no cumplen la Norma ST.91, ya sea total o parcialmente, no es necesario revisar la Norma ST.91 en un futuro próximo. El responsable del Equipo Técnico propone que los Estados miembros participen en sus actividades y trabajen en la aplicación de la norma.

Con el fin de facilitar el debate sobre la búsqueda y comparación de representaciones visuales en 3D, el responsable del Equipo Técnico tiene previsto compartir sus métodos y prácticas a la hora de llevar a cabo el procesamiento 3D a 3D con los miembros del Equipo Técnico; de este modo, se realizará una transferencia de conocimientos que mejorará su competencia en este ámbito. Para lograr este objetivo, el responsable del Equipo Técnico propone organizar una sesión de información en 2025 para presentar esas prácticas y conocer la experiencia de las Oficinas de PI interesadas en la utilización de los formatos 3D.

Si el CWS aprueba el análisis de la encuesta, se propone que sea publicado, junto con los resultados de la encuesta, en la Parte 7 del Manual de la OMPI.

*Se invita al CWS a:*

1. *tomar nota del contenido del presente documento;*
2. *examinar y aprobar el contenido del análisis de la encuesta, como se indica en los párrafos 5 a 12, y aprobar la publicación del análisis de la encuesta, junto con los resultados, en el Manual de la OMPI, como se indica en el párrafo 15; y*
3. *apoyar la organización de la sesión de información sobre objetos 3D por parte del Equipo Técnico, como se indica en el párrafo 14.*

[Fin del documento]